

公司代码：688409

公司简称：富创精密

**沈阳富创精密设备股份有限公司**  
**2023 年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）网站仔细阅读年度报告全文。

### 2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

### 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），并拟以资本公积向全体股东每10股转增4.8股。截至本公告日，公司总股本为209,053,334股，扣减回购专用账户的股数2,856,124股，以此计算合计拟派发现金红利103,098,605元（含税），拟合计转增98,974,660股，转增后公司的总股本增加至308,027,994股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准）。

上述利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1 公司简介

#### 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A股）	上海证券交易所科创板	富创精密	688409	/

#### 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 联系人和联系方式

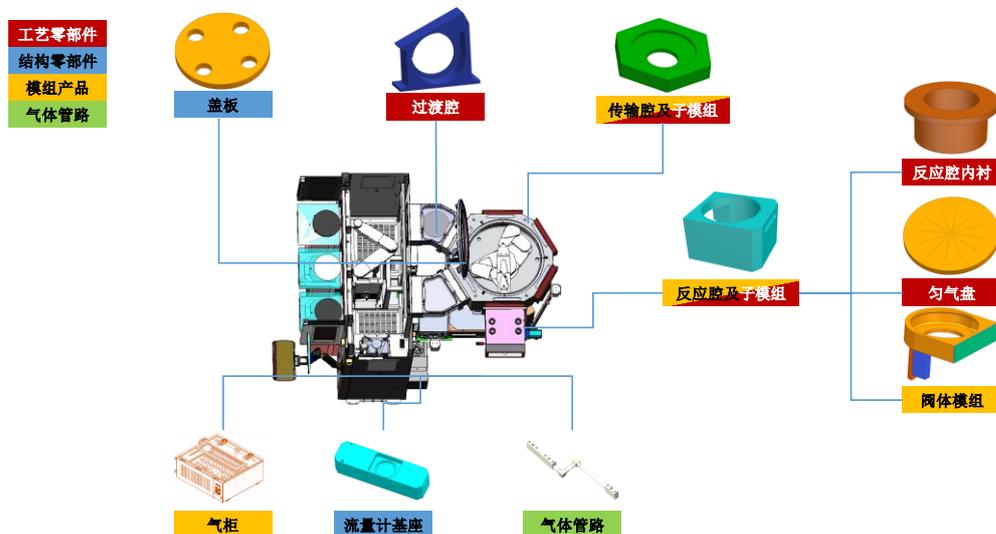
联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	梁倩倩	梁倩倩
办公地址	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号	辽宁省沈阳市浑南区飞云路18甲-1号
电话	024-31692129	024-31692129
电子信箱	zhengquanbu@syamt.com	zhengquanbu@syamt.com

### 2 报告期公司主要业务简介

#### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

##### 1、主要产品及产品应用领域

公司的产品为半导体设备、泛半导体设备及其他领域的精密零部件，具体包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路。以刻蚀设备为例，公司部分具体产品的应用例示如下：



### **(1) 工艺零部件**

工艺零部件主要是半导体设备中晶圆制备工艺的关键零部件，少量应用于泛半导体设备及其他领域。该产品一般需要经过高精密机械制造和复杂的表面处理特种工艺过程，具备高精密、高洁净、超强耐腐蚀能力、耐击穿电压等特点。工艺零部件主要应用于刻蚀设备、薄膜沉积设备，也少量应用于离子注入设备和高温扩散设备等。公司代表性工艺零部件包括腔体（按使用功能分为过渡腔、传输腔和反应腔）、内衬、匀气盘、铝基加热盘。

### **(2) 结构零部件**

结构零部件应用于半导体设备、面板及光伏等泛半导体设备和其他领域中，一般起连接、支撑和冷却等作用，对平面度和平行度有较高的要求，部分结构零部件同样需要具备高洁净、强耐腐蚀能力和耐击穿电压等性能。公司代表性结构零部件包括托盘轴、铸钢平台、流量计底座、定子冷却套、冷却板等。

### **(3) 模组产品**

工艺零部件、结构零部件等自制零部件与外购的电子标准件和机械标准件等经过组装、测试等环节，可以制成具有特定功能的模组产品，主要应用于半导体设备。公司主要模组产品包括离子注入机模组、传输腔模组、过渡腔模组、刻蚀阀体模组和气柜模组。

### **(4) 气体管路产品**

气体管路产品主要应用于半导体设备中的特殊工艺气体传送，是连接气源到反应腔的传输管道。由于晶圆加工过程中的气体具有纯度高、腐蚀性强、易燃易爆及毒性的特点，因此对管路的密封性、洁净度及耐腐蚀能力有较高要求。此外，一旦发生气体污染，半导体设备厂商较难排查。因此，对零部件制造商的过程管控能力及体系认证要求极高。为满足客户严苛的标准，公司需要在洁净间环境内，利用超洁净管路焊接技术及清洗技术并结合专属生产设备及自制工装来保证气体管路无漏点且管路内焊缝无氧化和缺陷，以保证气体在传输过程中的洁净度且不发生泄漏。此外，公司开发了应用于管路内部的镀膜工艺，实现了管路内壁的均匀镀膜，大大提升了膜层的耐化学腐蚀性。

## **(二) 主要经营模式**

### **1、采购模式**

#### **(1) 原材料采购**

公司制定了严格的合格供应商准入制度，通过询价、比价、议价方式在合格供应商名录中确定供应商。对于主要原材料，公司一般与合格供应商签订框架协议锁定年度价格。由于部分公司

客户对部分原材料的供应商存在复杂、长期的认证过程，且要求保障原材料质量的稳定、一致性和可追溯性，因此，存在部分客户指定原材料品牌或指定原材料供应商的情形。

## **(2) 外协采购**

公司外协主要包括特种工艺外协和机械制造外协两种情形。对于一部分公司不具备能力或尚未成熟的特种工艺制程，公司会进行委外加工。公司基于成本和交付周期考虑，将少量机械制造工序委托给进入公司合格供应商名录的外协厂商，在降低成本的同时灵活调节产能。

## **2、生产模式**

公司的生产模式主要是以销定产模式，即根据客户的订单情况制定生产计划并组织生产。鉴于公司客户对供应商和产品的认证周期较长，公司首先在完成客户的各项认证后，方才进行批量生产。

## **3、销售及服务模式**

公司采用直销的销售模式，通过与国内外龙头客户的合作能够及时掌握市场动态和行业发展趋势，不断提升公司技术水平和行业知名度。

产品定价方面，公司以产品生产流程预估的材料成本、制造费用、工艺水平和检测费用等为基础，根据市场竞争情况、公司市场策略和目标利润等因素制定定价策略，再根据客户设备的类型、工艺水平和预估销售台套，与客户协商确定产品的销售单价。

## **4、研发模式**

半导体设备是半导体工艺制程演进的关键，精密零部件是半导体设备的基础，因此半导体设备要发展，精密零部件的研发需要先行。随着半导体设备和半导体设备精密零部件的不断升级，研发能力的提升尤为关键。

在报告期内，公司通过推进自研项目、与客户协同研发、联合高校协同研发三方面推进研发工作，持续加大技术研发投入，致力于提升产品性能和工艺水平。

## **5、盈利模式**

公司以精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接技术、模组技术为核心，通过向国内外客户销售半导体设备精密零部件及模组产品等相应收入，扣除成本、费用等相关支出，形成公司的盈利。

## **(三) 所处行业情况**

### **1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛**

#### **(1) 行业的发展阶段、基本特点**

SEMI 发布《300mm 晶圆厂 2027 年展望报告(300mm Fab Outlook Report to 2027)》指出，由于内存市场复苏以及对高效能运算和汽车应用的强劲需求，全球用于前端设施的 300mm 晶圆厂设备支出预估在 2025 年首次突破 1000 亿美元，到 2027 年将达到 1370 亿美元的历史新高。全球 300mm 晶圆厂设备投资预计将在 2025 年成长 20%至 1165 亿美元，2026 年将成长 12%至 1305 亿美元，将在 2027 年创下历史新高。

国内来看，SEMI 预计中国大陆在全球半导体产能中的份额将持续增加，2023 年中国大陆产能同比增长 12%，达到每月 760 万片晶圆；预计中国大陆芯片制造商将在 2024 年开始运营 18 个项目，2024 年产能同比增加 13%，达到每月 860 万片晶圆。到 2025 年，中国大陆、中国台湾和韩国仍将是全球设备支出的前三大目的地。根据中国电子专用设备工业协会数据，2022 年集成电路晶圆制造关键设备进口零部件金额约占设备市场的 40%左右，部分国产半导体设备公司的零部件进口额达到 60%，影响了国产设备在国内市场竞争力，后续随着自主研发的关键半导体设备和核心部件进入量产生产线，替代进口产品，国产设备的市场竞争力将显著提升。

## (2) 主要技术门槛

半导体设备是延续行业“摩尔定律”的瓶颈和关键，而半导体设备的升级迭代有赖于精密零部件技术首先突破。创新是富创取得竞争优势的关键。公司加大资源投入力度，通过持续的研发和创新提升制造工艺和技术水平，以满足客户对高质量产品的需求。

半导体设备精密零部件具有高精度、高洁净、超耐腐蚀能力、耐击穿电压等特性，生产工艺涉及精密机械制造、工程材料、表面处理特种工艺、电子电机整合及工程设计等多个领域和学科，是半导体设备制造环节中难度较大、技术含量较高的环节之一，也是国内半导体设备企业“卡脖子”的环节之一。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

随着晶圆制造向 7 纳米以及更先进的制程工艺发展，半导体设备的工艺规格越来越高，零部件的制造精密度、洁净度要求将越来越高，对相应工艺技术要求也将随之提升。目前，公司是国内少有的能够提供满足甚至超过国际主流客户标准的精密零部件产品的供应商，也是全球为数不多的能够为 7 纳米工艺制程半导体设备批量提供精密零部件的厂商。

大陆以外，公司已进入客户 A、东京电子、HITACHI High-Tech 和 ASMI 等全球半导体设备龙头厂商供应链体系，并且是客户 A 的全球战略供应商。同时，伴随着国内半导体晶圆厂的大幅扩产和半导体设备国产化的进程加快，国内半导体设备精密零部件的国产化率将不断提升。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

伴随全球行业格局的变化，半导体行业设备公司在专注自身工艺技术与平台建设的同时，也愈加重视产业生态布局，半导体零部件公司的国际化水平、产能规模效应、与设备公司协同研发能力等，已成为半导体行业设备公司衡量供应商准入及准入后稳定性和完整性的重要因素之一。

从未来发展趋势看，由于半导体零部件行业存在一定技术门槛，少数企业占据市场主导地位的业态仍将长期存在。零部件公司通过全球化布局、拓展产能规模、构建研发及信息化能力加强自身实力，并通过上下游产业链协同等方式加强实力壁垒，行业头部效应将愈加明显。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2023年	2022年		本年比上年 增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	758,986.39	664,047.73	664,047.73	14.30	248,658.82	248,658.82
归属于上市公司股东的净资产	456,485.55	464,448.33	464,491.39	-1.71	104,785.31	104,810.06
营业收入	206,575.59	154,446.33	154,446.33	33.75	84,312.82	84,312.82
归属于上市公司股东的净利润	16,868.79	24,545.58	24,563.89	-31.28	12,624.42	12,649.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,639.02	17,805.17	17,823.48	-51.48	7,459.97	7,484.73
经营活动产生的现金流量净额	-38,638.18	-2,232.42	-2,232.42	不适用	15,733.96	15,733.96
加权平均净资产收益率(%)	3.61	12.19	12.19	减少8.58个百分点	12.90	12.90
基本每股收益(元/股)	0.81	1.45	1.45	-44.14	0.81	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.81	1.45	1.45	-44.14	0.81	0.81
研发投入占营业收入的比例(%)	9.97	7.89	7.89	增加2.08个百分点	8.80	8.80

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	34,139.55	48,714.35	56,149.49	67,572.19
归属于上市公司股东的净利润	3,938.81	5,629.40	3,633.47	3,667.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	363.86	2,155.57	1,187.02	4,932.57
经营活动产生的现金流量净额	-9,708.15	-20,530.72	-16,437.97	8,038.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 4 股东情况

### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)		9,859						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		9,498						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)		0						
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)		0						
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记 或冻结情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
沈阳先进制造 技术产业有限 公司	0	35,349,500	16.91	35,349,500	35,349,500	无	0	境内 非国 有法 人

宁波祥浦创业投资合伙企业（有限合伙）	0	33,810,800	16.17	33,810,800	33,810,800	无	0	其他
国投（上海）创业投资管理有限公司—国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）	0	28,571,400	13.67	0	0	无	0	其他
郑广文	0	10,000,000	4.78	10,000,000	10,000,000	无	0	境内自然人
海通新能源私募股权投资管理有限公司—辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	10,000,000	4.78	0	0	无	0	其他
辽宁科发实业有限公司	-24,600	9,975,400	4.77	0	0	无	0	国有法人
宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）	0	6,000,000	2.87	6,000,000	6,000,000	无	0	其他
霍尔果斯浑璞股权投资管理有限公司—宿迁浑璞六期集成电路产业基金	-277,828	3,372,172	1.61	0	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—南方信息创新混合型证券投资基金	2,487,732	2,487,732	1.19	0	0	无	0	其他
中信证券—中信银行—中信证券富创精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	-851,663	2,373,797	1.14	0	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，沈阳先进与宁波芯富存在关联关系，同为郑广文控制的企业；宿迁浑璞、青岛浑璞均受霍尔果斯浑璞股权投资管理有限公司（现用名“青岛浑璞守一私募基金管理有限公司”，任执行事务合伙人）控制。上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

#### 存托凭证持有人情况

适用 不适用

#### 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

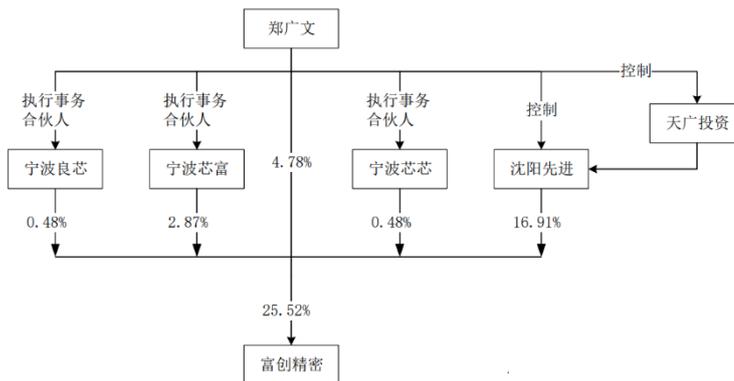
适用 不适用

#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入 206,575.59 万元，较上年同期增长 33.75%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,868.79 万元，较上年同期下降 31.28%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益的净利润 8,639.02 万元，较上年同期下降 51.48%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用